

国投证券股份有限公司

关于深圳市深科达智能装备股份有限公司

变更部分募投项目并新增募投项目、向子公司提供借款以

实施新募投项目及新设募集资金专户的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“深科达”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规的规定，对深科达变更部分募投项目并新增募投项目、向子公司提供借款以实施新募投项目及新设募集资金专户事项进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1235号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司向不特定对象发行可转换公司债券360万张，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行合计募集资金总额为人民币360,000,000.00元，扣除承销及保荐费、律师费、审计、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（不含税）人民币9,180,886.77元后，实际募集资金净额为人民币350,819,113.23元。上述募集资金已全部到账，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了大华验字[2022]第000569号《验资报告》。

募集资金到账后，为规范募集资金管理和使用，公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

二、募集资金投资项目及使用情况

（一）募集资金投资项目

根据公司披露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》以及公司 2022 年 9 月 7 日披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-053），公司可转债募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	子项目名称	项目投资总额	调整前募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额
1	深科达智能制造创新示范基地续建工程	惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目	15,504.83	11,766.50	11,466.43
2		半导体先进封装测试设备研发及生产项目	12,521.87	8,925.59	8,697.99
3	深科达智能制造创新示范基地	平板显示器件自动化专业设备生产建设项目	25,807.94	5,307.91	5,172.50
4	补充流动资金	/	10,000.00	10,000.00	9,745.00
合计			63,834.64	36,000.00	35,081.91

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	子项目名称	项目投资总额	拟投入金额	募集资金累计投入金额
1	深科达智能制造创新示范基地续建工程	惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目	15,504.83	11,466.43	24.88
2		半导体先进封装测试设备研发及生产项目	12,521.87	8,697.99	-
3	深科达智能制造创新示范基地	平板显示器件自动化专业设备生产建设项目	25,807.94	5,172.50	5,172.50
4	补充流动资金	/	10,000.00	9,745.00	9,745.00
合计			63,834.64	35,081.91	14,942.38

三、本次拟变更部分募投项目的情况及原因

（一）本次拟变更部分募投项目的情况

本次拟变更项目为“深科达智能制造创新示范基地续建工程”（以下简称“原

募投项目”)，项目实施地为惠州市仲恺高新区，实施主体为公司全资子公司惠州深科达智能装备有限公司。

原募投项目中，子项目“惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目”拟通过建设生产与办公场地，购置先进生产设备及产线，用于新型显示智能装备生产，以扩大公司生产能力和产能规模；子项目“半导体先进封装测试设备研发及生产项目”拟通过建设生产与办公场地、购置先进的研发及生产设备，以满足公司半导体先进封装测试设备研发及生产所需。

原募投项目变更后，公司拟将剩余募集资金 21,056.95 万元（含利息及理财收益）投入新募投项目使用。具体情况如下：

单位：万元

原募投项目			新募投项目		
项目名称	募集资金拟投资金额	剩余募集资金金额	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目	11,466.43	11,973.96	新型显示设备研发项目	9,000.00	9,000.00
半导体先进封装测试设备研发及生产项目	8,697.99	9,082.99	半导体新一代测试设备研发项目	7,500.00	7,500.00
			核心零部件研发项目	4,556.95	4,556.95
合计	20,164.42	21,056.95	合计	21,056.95	21,056.95

（二）本次拟变更部分募投项目的原因

原募投项目是公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的，旨在建设生产与办公场地、购置先进的研发及生产设备，满足研发及生产所需，以扩大公司生产能力和产能规模。虽然公司在项目立项时进行了充分的研究与论证，但近年来受经济环境日趋严峻以及国际局势动荡等因素影响，消费电子行业表现较为疲软，整体恢复不及预期，显示面板产品需求未出现明显增长。

此外，公司首发募投项目“平板显示器件自动化专业设备生产建设项目”已于2022年底投入使用，但受宏观经济环境以及下游需求波动等因素的影响，近年来公司订单情况不如预期，首发募投项目自建成投入使用以来，公司产能未完全释放，募投项目场地出现一定的闲置。公司评估现有场地能够满足公司平板显示设备业务现阶段的发展需求。全力消化已有产能，同时预留时间为公司平板显示模组类设备的技术路径提供充分验证，是更为稳健的经营策略选择。

原募投项目中涉及的先进封装设备的研发需持续高投入，公司若继续推进原项目，可能面临研发周期超预期、客户验证不通过、资金回笼缓慢的三重风险。虽然目前少量国内厂商在划片机、探针台等先进封装设备取得了一定进展，但是半导体先进封装设备国产替代化增速依然较慢，主要受划片机、探针台对设备精度和稳定性的高要求影响。相比之下，传统封装设备具备研发周期更短、客户认证更快、现金流更稳定的优势，且当前国内传统设备市场仍存在结构性缺口，也保持了对传统封装设备的需求。因此，公司拟将半导体先进封装测试设备项目变更为半导体新一代测试设备研发项目（涵盖传统封装与先进封装）。

综上，公司经审慎论证评估，综合考虑宏观环境、市场环境和行业发展变化，以及公司现有产线产能等多方面因素，结合市场和项目实际情况、整体的业务布局及战略规划，认为“深科达智能制造创新示范基地续建工程”募投项目达到预期效益存在较大不确定性，本着审慎使用募集资金的原则，公司拟变更“深科达智能制造创新示范基地续建工程”，并将上述募投项目剩余募集资金用于新募投项目。

四、剩余募集资金使用计划

截至 2025 年 6 月 30 日，原募投项目“深科达智能制造创新示范基地续建工程”剩余募集资金为 21,056.95 万元（含利息及理财收益）。

根据公司经营发展规划安排，在原募投项目变更后，公司拟新增“新型显示设备研发项目”、“半导体新一代测试设备研发项目”、“核心零部件研发项目”3 个募投项目。新增募投项目情况如下：

序号	新增募投项目	实施主体	拟投资金额 (万元)
1	新型显示设备研发项目	深圳市深科达智能装备股份有限公司及惠州深科达智能装备有限公司	9,000.00
2	半导体新一代测试设备研发项目	深圳市深科达半导体科技有限公司及惠州深科达半导体科技有限公司	7,500.00
3	核心零部件研发项目	深圳线马科技有限公司及惠州线马科技有限公司	4,556.95
合计			21,056.95

五、新增募投项目具体情况

（一）新型显示设备研发项目

1、项目实施主体：深圳市深科达智能装备股份有限公司及惠州深科达智能装备有限公司

2、项目实施地点：深圳市宝安区及惠州市仲恺高新区

3、项目建设内容：专注于 OLED 显示生产设备、Mini/MicroLED 显示设备、AR/VR 镜片贴合组装设备、电子纸贴合设备、指纹模组设备等一系列新型显示设备的研发

4、项目建设期：3 年（2025 年 10 月至 2028 年 10 月）

5、项目投资规模：总投资额为 9,000.00 万元，具体规划如下：

序号	项目	投资总额（万元）	拟使用募集资金金额（万元）
1	研发人员薪酬	6,200.00	6,200.00
2	研发物料	2,000.00	2,000.00
3	其他研发费用	800.00	800.00
合计		9,000.00	9,000.00

6、实施本项目的必要性

（1）丰富公司产品结构，提高市场份额

随着技术的不断进步以及电子产品消费需求的不断变化，全球平板显示模组设备行业正处于技术革新、市场格局重塑、应用领域拓展的关键转型期。在此期间，行业内传统技术与新兴技术并存，不同市场主体竞争态势各异，市场需求也呈现出多元化趋势。一方面，LCD 技术已进入成熟阶段，成本控制与规模效益显著。全球 LCD 面板产能充足，生产工艺高度标准化，设备制造技术成熟，能够实现大规模稳定生产，充分满足各领域对中低端显示产品的需求。另一方面，OLED、Mini-LED、Micro-LED 等新型显示技术正处于快速发展与市场渗透阶段。

本项目旨在公司现有平板显示模组类设备的基础上，研发满足市场需求的新型显示设备，丰富公司产品种类，在优化产品结构的同时也增强公司规模效应，满足客户需求，建立并巩固良好的客户渠道，提高市场份额。

（2）把握行业发展时代机遇，提升公司综合实力

根据恒州诚思（YHResearch）调研数据，2023 年全球平板显示设备市场规模约为 1,243 亿元，预计到 2030 年，市场规模将接近 1,588 亿元，未来六年 CAGR 约为 3.1%。根据智研咨询整理的的数据，2023 年中国平板显示面板市场规模约为 2,260.8 亿元，同比增长 8.46%。在应用领域方面，除传统消费电子外，车载显示、

工业显示、智能家居、商业显示、AR/VR 可穿戴设备等新兴应用领域发展迅速，成为行业新的增长点。新兴应用领域对显示技术与设备提出了多样化、定制化的需求，推动行业向更细分、更专业的方向发展。公司有必要顺应行业技术发展趋势，坚持对行业新技术、新工艺、新产品的研究，保持自身原有平板显示器件自动化专业设备技术优势的同时，投入力量从事新型显示领域的设备研制，不断推出满足市场需求的新产品，进一步增强公司的核心竞争力和综合实力。

7、实施本项目的可行性

（1）公司拥有较强的技术实力积累，为项目提供技术支持

平板显示器件生产设备行业是典型的技术密集型行业，技术集成难度高，产品开发难度大，公司长期专注于平板显示器件自动化专业设备研发和制造，技术优势突出。通过多年的持续努力，公司突破并掌握了精准对位、图像处理、运动控制、精密压合贴附等方面的核心技术，已具备提供涵盖 OLED 和 LCD 显示器件后段制程主要工序和工艺适用设备的能力，并拥有平板显示器件周边部件组装设备和检测设备的生产能力，能满足客户对于生产的特殊需求。公司在成本控制、产品质量、生产装配流程控制等方面的优势为公司产品顺利扩大产能、提高市场占有率提供了坚实的技术支持。

（2）公司拥有完善的团队管理体系，为项目提供制度保障

公司拥有完备的内部管理制度，包括采购、生产、质检、销售等各个环节。采购方面，制定了采购管理制度、采购作业流程等；生产方面，有生产车间管理制度、制造中心安全管理制度、装配部组装作业流程等文件；质量检验方面，制定了来料检验作业指导、成品检验作业规范、产品的监视和测量管理程序等。在研发方面，公司致力于依靠自主创新实现企业可持续发展，公司坚持以市场需求为导向的研发理念，注重技术的积累与创新，设立了多个事业中心或子公司负责承担具体的研发工作，构建了完善的研发体系，紧随平板显示产业发展趋势，形成了富有竞争力的研发创新能力。不仅如此，研发团队还密切跟踪并学习国际平板显示行业先进技术，及时把握下游行业发展动向，结合终端消费者的需求变化趋势，确立了一系列前瞻式研发项目，保证了公司在日益激烈的市场竞争中的技术研发优势。

8、项目实施的风险提示及应对措施

本次新增募投项目的可行性分析是基于当前市场环境、对未来市场趋势的预测等因素作出的。如果未来因宏观经济动荡导致下游需求低迷或行业内技术迭代导致公司本次募投项目的核心产品适用性降低,或出现产业政策、市场供需情况、行业竞争态势等方面的其他不利变化,公司将面临新增产能无法及时消化或未达预期效益的风险。

公司将密切关注市场动态及客户需求,根据公司实际情况对募集资金投资进行适时安排,实施全程跟踪控制,以最大程度降低有关风险事项对本项目顺利实施的不利影响。

9、项目效益情况

本项目为研发项目,不进行直接效益测算,效益将从公司后续推出的新产品和相应的技术支撑服务中接体现。

10、募集资金管理计划

本新增募投项目实施主体为深圳市深科达智能装备股份有限公司及惠州深科达智能装备有限公司,公司已对募集资金进行了专户存储管理,并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户三方监管协议》,公司将使用已有的募集资金账户,继续强化募集资金监管,落实专款专用。

(二) 半导体新一代测试设备研发项目

1、项目实施主体: 深圳市深科达半导体科技有限公司(以下简称“深科达半导体”)及惠州深科达半导体科技有限公司

2、项目实施地点: 深圳市宝安区及惠州市仲恺高新区

3、项目建设内容: 专注于半导体新一代平移式测试分选机、重力式测试分选机、双轨测试分选机、高温转塔测试分选机等新型分选机设备的研发

4、项目建设期: 3 年(2025 年 10 月至 2028 年 10 月)

5、项目投资规模: 总投资额为 7,500.00 万元, 具体规划如下:

序号	项目	投资总额(万元)	拟使用募集资金金额(万元)
1	研发人员薪酬	6,000.00	6,000.00
2	研发物料	1,000.00	1,000.00
3	其他研发费用	500.00	500.00
合计		7,500.00	7,500.00

6、实施本项目的必要性

（1）抓住行业发展机遇，提升公司竞争力

全球半导体行业正在飞速发展，半导体行业隶属于电子信息产业，产业链较长，产品应用涉及面广，覆盖 PC、通信、医疗、物联网、信息安全、消费电子、新能源、汽车等众多领域，随着 5G 通信、人工智能、大数据云计算、智能终端、智慧城市、智能家居、无人驾驶等产品和应用不断推陈出新，极大促进了半导体行业的发展。终端设备的智能化、功能多样化、轻薄小型化促使芯片封测技术不断向高密度、高速率、高散热、低功耗、低时延、低成本演进，集成电路设计拉动了半导体产业的技术进步和产品更新。

根据 Frost&Sullivan 数据，全球半导体测试设备市场规模从 2016 年的 23.5 亿美元增长至 2022 年的 75.8 亿美元，年复合增长率为 21.5%。预计将保持约 10.7% 的整体年复合增长率，2027 年全球半导体测试设备市场规模有望达 106.8 亿美元，其中，测试机、分选机、探针台全球市场规模分别有望达 65.7 亿美元、24.6 亿美元、16.6 亿美元；中国半导体测试细分设备市场规模从 2016 年的约 50 亿元增长至 2022 年的约 190 亿元，年复合增长率为 24.9%，预计 2027 年可达 267.4 亿元，其中，测试机、分选机、探针台市场规模分别有望达 165.8 亿元、56.1 亿元、45.5 亿元。

据前瞻产业研究院预测，到 2026 年中国大陆封测市场规模将达到 4,429 亿元。全球半导体封测行业的快速发展，带动了我国半导体封测设备企业的发展，纵观我国半导体封测领域的发展现状，总体上呈现出快速增长态势，且近年来正在加速进入国产化替代阶段。为推动我国半导体专用设备制造的技术升级，国家出台了国家科技重大专项（02 专项）项目，国家《“十四五”数字经济计划》《中国制造 2025》等相关政策，半导体专用设备走上了国产化替代道路，研发高科技含量、高检测性能的半导体专用设备是我国半导体行业发展的必然趋势。

（2）丰富公司产品类别、满足客户需求、助推公司发展战略的实施

公司于 2016 年设立深科达半导体子公司正式进入半导体封测设备领域，并陆续向市场推出测试分光机、测试分选机等半导体封测系列产品，相关产品获得了市场的广泛认可，与长电科技、通富微电、华天科技、华润微、扬杰科技、苏州固锟、银河微电等优质客户建立了良好合作关系。结合全球及国内半导体行业发展前景，半导体设备业务是公司未来重点发展的战略方向之一，市场对半导体

测试设备的技术需求也在不断提高。本项目是基于公司长期发展战略规划，聚焦主营业务，通过进一步完善和丰富公司在半导体设备领域的布局，研发更高精度与高效率的测试设备，以满足客户需求，助推公司发展战略的实施。

7、实施本项目的可行性

（1）公司拥有强大的技术研发实力，为项目建设提供技术支持

半导体设备行业是典型的技术密集型行业，技术集成难度高，产品开发难度大，半导体设备与公司主营业务之一的平板显示设备具有较强的相关性，公司长期专注于智能化设备的研发及制造，在平板显示设备、检测设备、摄像模组类设备等智能装备制造领域积累了丰富的技术及制造经验，截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计获得了 432 项专利技术（其中发明专利 86 项）和 107 项软件著作权。公司已经掌握了半导体封测设备生产所需的精密视觉对位技术、图像识别技术、机器人与视觉融合技术、压力精密控制技术等技术，此外，公司全资子公司深科达半导体从 2016 年开始布局半导体设备行业，拥有丰富的行业经验，可为项目的开展提供有力的技术支撑和经验参考。

（2）公司拥有完善的管理体系和充足的人才储备

公司始终坚持让客户满意的理念，持续完善生产技术，制造一流产品；提供优质专业服务，通过持续改进和完善，建立了严格的质量标准和管理体系。为确保自动化设备的安全、稳定、精确运行，公司严格按照 ISO9001:2015 标准制定了一系列质量控制文件，并建立了以品质部为质量控制执行核心，市场中心、研发中心、制造中心等部门协助配合，全面覆盖原材料采购过程、生产装配过程、整机调试过程的全流程质量控制体系，保证了产品质量，赢得了客户的认可和信赖。公司始终重视人才队伍的建设和培养，建立了一套完善的“引、育、用、留”体系。经过多年的发展，公司形成了一支由研发技术人员、销售服务人员及核心管理人员组成的高度稳定的人才队伍。人员队伍涵盖机械、电气、软件、视觉、工艺、组装等不同技术领域的人才。公司完善的管理体系和充足的人才储备为本项目实施奠定了坚实基础。

（3）公司拥有优质的客户群体

公司致力于成为业界一流的智能制造装备企业，始终坚持以客户需求为中心，以客户满意度为宗旨，致力于以更高标准、更快响应、更优品质满足客户对产品

的需求。经过多年的发展，公司在产品研发、生产、销售、管理等方面都积累了丰富的行业经验，凭借日益精进的研发水平、领先的生产技术工艺、完善的销售服务、卓越的产品质量，在半导体封装测试设备领域，与长电科技、通富微电、华天科技、华润微、扬杰科技、苏州固锴、银河微电等优质企业建立了合作关系，积累了众多优质客户群体。

8、项目实施的风险提示及应对措施

本次新增募投项目的可行性分析是基于当前市场环境、对未来市场趋势的预测等因素作出的。如果未来因宏观经济动荡导致下游需求低迷或行业内技术迭代导致公司此次募投项目的核心产品适用性降低，或出现产业政策、市场供需情况、行业竞争态势等方面的其他不利变化，公司将面临新增产能无法及时消化，或未达预期效益的风险。

公司将密切关注市场动态及客户需求，根据公司实际情况对募集资金投资进行适时安排，实施全程跟踪控制，以最大程度降低有关风险事项对本项目顺利实施的不利影响。

9、项目效益情况

本项目为研发项目，不进行直接效益测算，效益将从公司后续推出的新产品和相应的技术支撑服务中间接体现。

10、募集资金使用及管理计划

本次新增募投项目相关审批程序履行完成后，公司将使用不超过 7,500.00 万元的募集资金向深科达半导体提供有息借款，以保障募投项目的实施。借款利率将参考借款协议签订之日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的同期贷款市场报价利率（LPR）。

同时，为强化募集资金监管，落实专款专用，项目实施主体将开立募集资金专用账户，专项存储投入的募集资金。董事会授权公司管理层办理开立募集资金专用账户并与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储多方监管协议等相关事宜。

11、借款对象的基本情况

（1）企业名称：深圳市深科达半导体科技有限公司

（2）企业类型：有限责任公司

(3) 住所：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 BC 座 B1008

(4) 法定代表人：黄奕宏

(5) 注册资本：410.256 万元人民币

(6) 成立日期：2016 年 7 月 4 日

(7) 经营范围：半导体行业智能化封装设备的技术开发、生产、测试与销售及技术服务；软件的研发与销售；国内贸易，经营进出口业务。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。

(8) 与公司的关系：为公司全资子公司，公司持有 100.00%的股权。

(9) 最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	32,102.17	29,408.29
负债总额	21,985.53	20,469.47
净资产	10,116.64	8,938.82
项目	2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年度（经审计）
营业收入	9,775.25	18,437.10
净利润	962.52	1,495.56

（三）核心零部件研发项目

1、项目实施主体：深圳线马科技有限公司（以下简称“线马科技”）及惠州线马科技有限公司

2、项目实施地点：深圳市宝安区及惠州市仲恺高新区

3、项目建设内容：专注于新一代直线电机、编码器等智能装备核心零部件的研发

4、项目建设期：3 年（2025 年 10 月至 2028 年 10 月）

5、项目投资规模：总投资额为 4,556.95 万元，具体规划如下：

序号	项目	投资总额（万元）	拟使用募集资金金额（万元）
1	研发人员薪酬	3,390.00	3,390.00
2	研发物料	780.00	780.00
3	其他研发费用	386.95	386.95
合计		4,556.95	4,556.95

6、实施本项目的必要性

全球智能制造核心零部件行业正处于快速发展、技术革新和市场重构的关键时期，以直线电机和直线模组为典型代表。直线电机是一种将电能直接转换为直线运动机械能，无需中间转换机构的传动装置，主要分为同步直线电机和感应直线电机两类。该行业目前已进入技术深化与市场拓展齐头并进的阶段。

从市场层面来看，行业规模总体呈现扩张趋势。随着全球制造业智能化转型进程的加快，不仅传统工业强国对智能制造核心零部件的需求持续增长，新兴经济体对智能制造升级的热情也日益高涨，为直线电机和直线模组创造了广阔的市场空间。在此背景下，行业竞争愈发激烈，头部企业依靠技术优势和品牌影响力不断扩大市场份额，中小企业则通过深耕细分领域探索差异化发展路径，产业格局正逐步优化。

目前，直线电机的主要应用领域包括电子、半导体、医疗等领域，随着下游应用场景的增加、技术的逐渐成熟，直线电机有望成为性价比更高的选择，行业规模也将随之快速增长。Transparency Market Research 数据显示，2022 年全球直线电机行业市场规模约为 18 亿美元，到 2031 年预计增长至 31 亿美元。根据相关市场机构调研数据，近几年中国直线电机市场规模增长较快，2023 年接近 26 亿元，预计 2025 年可突破 30 亿元。

智能制造装备是智能制造的基础，智能制造的重点任务之一就是发展智能制造装备。新一代信息技术、智能技术、自动化控制等先进制造技术，与制造装备相融合的智能制造是工业自动化的重要组成部分。政府大力支持智能制造并加快推动智能制造发展，根据《“十四五”智能制造发展规划》的内容，“十四五”及未来相当长一段时期，推进智能制造，立足制造本质，紧扣智能特征，以工艺、装备为核心，以数据为基础，依托制造单元、车间、工厂、供应链等载体，构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳的智能制造系统，推动制造业实现数字化转型、网络化协同、智能化变革。

综上，随着我国工业化进程的不断发展，为满足高速、高精度装配的需求，智能装备核心零部件产品将不断向高精度、高速度、高负载方向发展。而在工业智能化、半导体制造、医疗器械、新能源等多领域需求带动下，智能装备核心零部件的市场规模也将持续扩大。

7、实施本项目的可行性

（1）公司拥有深厚技术储备和经验丰富的研发团队

公司在智能装备领域深耕二十载，截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计获得了 432 项专利技术（其中发明专利 86 项）和 107 项软件著作权。公司子公司线马科技自 2015 年开始布局智能装备核心零部件领域，拥有一支经验丰富的研发团队，研发人员多为业内资深人士，技术经验丰富，可为项目的开展提供有力的技术支撑和经验参考。

（2）公司拥有持续研发投入能力和健全的研发体系

公司致力于依靠自主创新实现企业可持续发展，公司持续积极地投入资源，保持产品和服务的技术领先水平，维持公司的市场竞争优势。公司最近三年累计研发投入 22,968.53 万元，占累计营业收入的 13.87%。持续的研发投入保证了公司在产品方面可以不断创新。

公司拥有完整的研发流程和成果留存制度，已形成了成熟的研发体系。公司同时拥有完备的内部管理制度，包括采购、生产、质检、销售等各个环节，为产品的研发提供后续保障。

8、项目实施的风险提示及应对措施

本次新增募投项目的可行性分析是基于当前市场环境、对未来市场趋势的预测等因素作出的。如果未来因宏观经济动荡导致下游需求低迷或行业内技术迭代导致公司此次募投项目的核心产品适用性降低，或出现产业政策、市场供需情况、行业竞争态势等方面的其他不利变化，公司将面临新增产能无法及时消化，或未达预期效益的风险。

公司将密切关注市场动态及客户需求，根据公司实际情况对募集资金投资进行适时安排，实施全程跟踪控制，以最大程度降低有关风险事项对本项目顺利实施的不利影响。

9、项目效益情况

本项目为研发项目，不进行直接效益测算，效益将从公司后续推出的新产品和相应的技术支撑服务中间接体现。

10、募集资金使用及管理计划

本次新增募投项目相关审批程序履行完成后，公司将使用不超过 4,556.95 万元的募集资金向线马科技提供有息借款，以保障募投项目的实施。借款利率将参

考借款协议签订之日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的同期贷款市场报价利率（LPR）。

同时，为强化募集资金监管，落实专款专用，项目实施主体将开立募集资金专用账户，专项存储投入的募集资金。董事会授权公司管理层办理开立募集资金专用账户并与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储多方监管协议等相关事宜。

11、借款对象的基本情况

- (1) 企业名称：深圳线马科技有限公司
- (2) 企业类型：有限责任公司
- (3) 住所：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 BC 座 B1005
- (4) 法定代表人：黄奕宏
- (5) 注册资本：277.7778 万元人民币
- (6) 成立日期：2015 年 7 月 13 日
- (7) 经营范围：精密直线电机、精密直线电机模组、精密直线电机平台、精密运动控制系统的技术开发以及上述产品和高端自动化设备及其配件的研发、生产、销售、进出口及相关配套业务；国内贸易。
- (8) 与公司的关系：为公司控股子公司，公司持有 80.92%的股权。
- (9) 最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	18,872.76	16,359.42
负债总额	6,467.89	5,160.93
净资产	12,404.87	11,198.49
项目	2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年度（经审计）
营业收入	6,565.15	10,190.79
净利润	1,206.38	1,843.72

六、对公司的影响

本次变更部分募投项目并将剩余募集资金投入新增募投项目，是公司结合实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公

司的正常生产经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排，有利于公司长远发展。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。

本次使用募集资金向子公司提供有息借款，是基于新增募投项目的建设需要，有利于保障新增募投项目的顺利开展和实施，符合募集资金使用计划，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于公司长远发展。

七、履行的审议程序

公司于 2025 年 9 月 29 日召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目并新增募投项目、向子公司提供借款以实施新募投项目并新设募集资金专户的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。

八、保荐机构意见说明

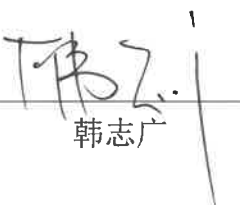
经核查，保荐机构认为，公司变更部分募投项目并新增募投项目、向子公司提供借款以实施新募投项目及新设募集资金专户事项，已经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议分别审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议；针对该事项，公司履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的规定，本次变更部分募投项目并新增募投项目系公司为提高募集资金使用效率，根据业务发展实际需要做出的审慎决策，不存在损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对深科达本次变更部分募投项目并新增募投项目、向子公司提供借款以实施新募投项目及新设募集资金专户事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于深圳市深科达智能装备股份有限公司变更部分募投项目并新增募投项目、向子公司提供借款以实施新募投项目及新设募集资金专户的核查意见》之签章页）

保荐代表人：


韩志广


赵 跃

国投证券股份有限公司

2025年9月30日

